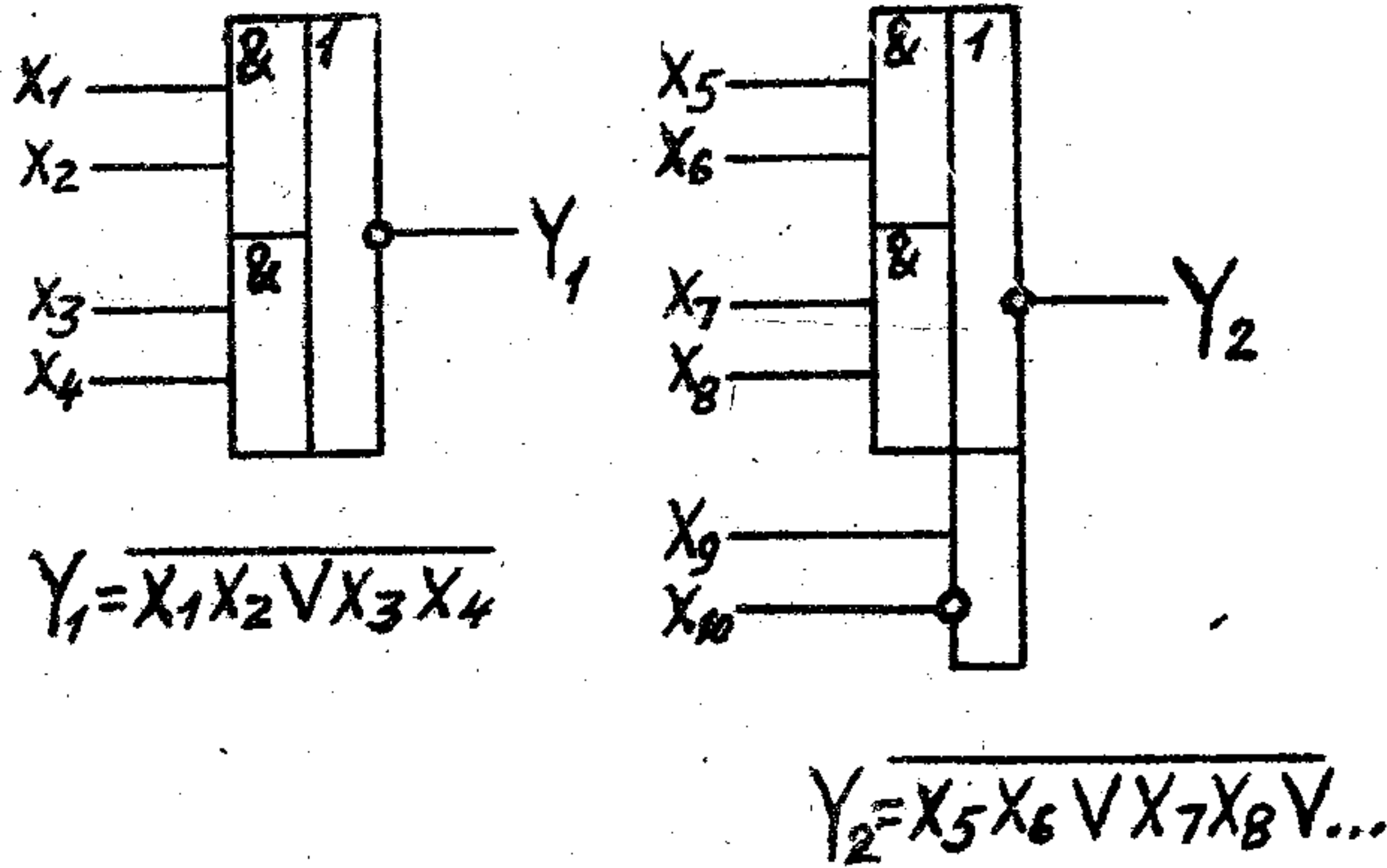


# П А С П О Р Т

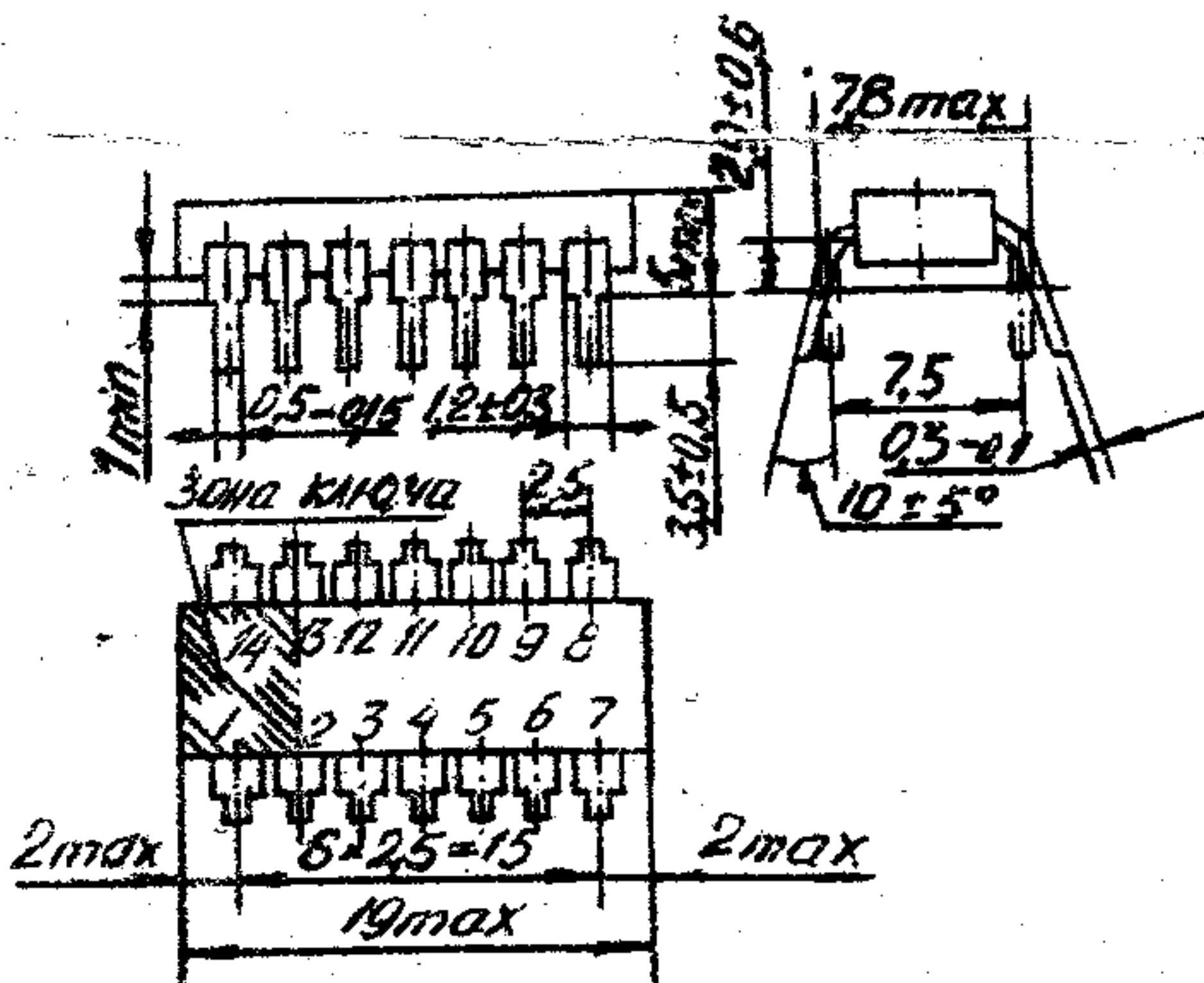
Микросхема типа КЛДР551 соответствует  
техническим условиям 0.348.006 ТУ

I. Функциональное назначение - два логических элемента "2-2И-2ИЛИ-НЕ", один расширяемый по "ИЛИ".

Таблица I



Вывод	Назначение
1	Вход X <sub>5</sub>
2	Вход X <sub>1</sub>
3	Вход X <sub>2</sub>
4	Вход X <sub>3</sub>
5	Вход X <sub>4</sub>
6	Выход Y <sub>1</sub>
7	Общий
8	Выход Y <sub>2</sub>
9	Вход X <sub>7</sub>
10	Вход X <sub>8</sub>
11	Вход расширяемый X <sub>9</sub>
12	Вход расширяемый X <sub>10</sub>
13	Вход X <sub>6</sub>
14	Питание E



3. Масса микросхемы, не более 1 г
4. Содержание золота в одной микросхеме 0,006831 г
5. Напряжение питания E = +5 В ± 5%
6. Электрические параметры при температуре +20 ± 5°C

Таблица 2

Наименование	Норма
Нагрузочная способность, V	10
Время задержки выключения $t_3^{01}$ , нс, не более	22
Время задержки включения $t_3^{10}$ , нс, не более	15
Выходное напряжение "лог.0" U <sub>вых</sub> , В, не более	0,4
Выходное напряжение "лог.1" U <sub>вых</sub> , В, не менее	2,4

7. Предельно допустимые условия эксплуатации.

Диапазон рабочей температуры от минус 10 до +70°C.

Предельно допустимое кратковременное напряжение питания составляет 7 В в течение времени 5 миллисекунд.

8. Срок хранения - 12 лет.

9. Время гарантийной наработки.

Гарантируется соответствие микросхемы требованиям технических условий при наработке 10000 часов. Гарантии исчисляются со дня отгрузки микросхемы потребителю.

10. Указание и рекомендации по эксплуатации.

Преплинение микросхемы к печатной плате в аппаратуре может быть произведено методом пайки выводов.

Расстояние от места пайки вывода до корпуса микросхемы должно быть не менее 2,5 мм.

Пайку следует производить с принятием мер, исключающих повреждение микросхемы из-за перегрева и механических усилий.

При пайке рекомендуется применять припой ПОС-61 ГОСТ 1499-70 и флюс ФКСп по НО.054.063. При пайке с помощью паяльника последний должен быть обязательно заземлен и иметь мощность не более 60 Вт.

При пайке температура не должна превышать 260°C, а время воздействия этой температуры на микросхему не более 5 с.

После монтажа микросхема должна быть защищена в соответствии с нормалью НО.054.021.

С целью повышения надежности аппаратуры рекомендуется принимать меры, обеспечивающие минимальную температуру нагрева корпуса микросхем и защиту от воздействий климатических факторов.

При ремонте аппаратуры замену микросхем необходимо производить только при отключенных источниках питания.

Дата выпуска

июль 1970

